



2021年6月30日

各 位

会 社 名 株式会社**フェローテックホールディングス**

代 表 者 名 代表取締役社長 賀 賢 漢
(J A S D A Q ・ コード 6 8 9 0)

問 合 わ せ 先 執行役員 IR 室長 佐 藤 昭 広
(0 3 - 3 2 8 1 - 8 1 8 6)

(開示事項の訂正) 半導体ウェーハ持分法適用関連会社の上場に関するお知らせ

2021年6月29日付開示「半導体ウェーハ持分法適用関連会社の上場に関するお知らせ」にてお知らせしました内容について精査しましたところ、一部の表現について誤謬がありましたので、本開示にて訂正させていただきます。

記

(訂正前) 下線部が訂正部分です。

1. 科創板市場への上場時期について

予定通り上場準備が整えば、今期決算(2021年12月期)を基準決算期として、2022年6月に科創板市場へ上場する予定です*。

※今後の上場承認を保証するものではありません。また、上場承認が得られた場合でも、株式市況ならびに事業環境の変化等を理由として上場申請を取りやめる場合があります。

2. 同社の英文名の略称変更の件

省略

3. 持ち分適用関連会社の概要(2020年12月31日現在)

省略

4. 今後の見通し

省略

(訂正後) 下線部が訂正部分です。

1. 科創板市場への上場時期について

予定通り上場準備が整えば、今期決算(2021年12月期)を基準決算期として、2022年6月に科創板市場へ上場申請をする予定です*。

※今後の上場承認を保証するものではありません。また、上場承認が得られた場合でも、株式市況ならびに事業環境の

変化等を理由として上場申請を取りやめる場合があります。

2. 同社の英文名の略称変更の件

省略

3. 持ち分適用関連会社の概要（2020年12月31日現在）

省略

4. 今後の見通し

省略

以上

この文書は、当社の持分法適用関連会社である杭州中欣晶圓半導体股份有限公司の上海証券取引所科創板市場への株式上場へ向けた準備に関して一般に公表することのみを目的としたプレスリリースであり、日本国内外を問わず投資勧誘等を目的として作成されたものではありません。